

セミコンダクタ&エレクトロニクス(SE)

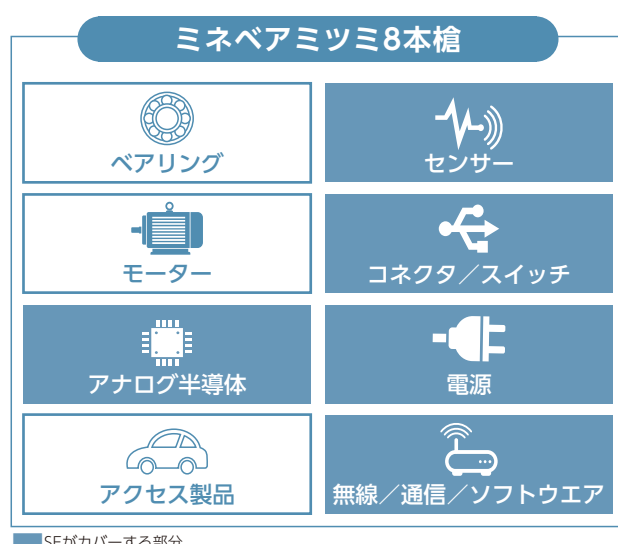
8本槍製品の相合により今後の成長分野に向けた新製品を開発し、グループ全体の事業機会を創出

常務執行役員
セミコンダクタ&
エレクトロニクス
事業本部長
岩熊 勝行



コア・コンピタンス

SEは、センサー、光学、MEMS（微小電気機械システム）、高周波技術、電気回路技術、半導体設計技術に代表される超微細加工が求められる分野における技術開発力が競争力の原点です。さらに、ミツミ、エイブリック、本多通信工業、ミネベアコネクト（旧住鋺テック）との経営統合によりミネベアミツミのDNAである超精密加工や垂直統合等のコア技術が融合したことで、開発から量産まで顧客の細かなニーズに一气通貫で対応する体制を整備しています。アナログ半導体をはじめとする8本槍製品のうち5製品がSEに属し、グループ全体の「相合」を創出する原動力となっています。



機会

- 車載、コミュニケーション、医療等の主要分野におけるさらなる低消費電力・小型・高精度化へのニーズ拡大。
- 高電圧・高電流などに対応するアナログ半導体、コネクタ、電源などの需要拡大。
- AI/ビッグデータを背景とする自動車、住宅機器、インフラ等のコネクティブティ向上。

リスク

- 既存技術を代替する新技術/アプリケーションの台頭。
- 中国における低コストな競合メーカーの台頭。
- 米中貿易摩擦に伴うハイテク産業に対する規制強化。
- 半導体の業界再編による大型M&Aと寡占化。

機会とリスクへの対応

- 技術力をいかした新製品の開発および新規顧客の開拓に注力。
- 事業の成長フェーズに合わせた設備投資計画の見極め。
- アナログ半導体の能力拡張および社内リソースとのシナジー創出による競争力の強化。

2023年3月期の概要

光デバイスの好調な受注を受けて増収となりました。また、本多通信工業、ミネベアコネクトが加わり、コネクタ部門も強化しています。売上高は5,305億円、営業利益は427億円、営業利益率は8.1%となりました。

※特殊要因を除いた営業利益478億円、営業利益率9.0%

2024年3月期の見通し

光デバイス、半導体は引き続き堅調を維持するものの、製品サイクルにより、機構部品で減収減益を想定していることから、全体としては若干の減収減益を見込んでいます。

中期事業計画

半導体、アクチュエータが成長を牽引

主なポイント

- 1 光デバイス
当社製品搭載率上昇で堅調に推移
- 2 アナログ半導体
市場回復と滋賀工場の貢献
パワー半導体を中心にニッチ市場で成長を加速
- 3 機構部品
相合力を活用し
新規OEMビジネス開拓へ
- 4 コネクタ
統合効果による成長

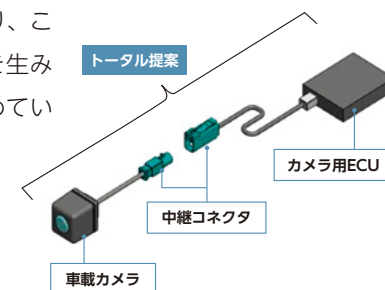
『「相合力」でオンリーワンを目指す』戦略

2023年、ミネベアミツミは本多通信工業、ミネベアコネクトとの経営統合を実施しました。この経営統合により、技術・生産・販売シナジーを実現し、8本槍の一つとしてコネクタ事業を強靱化するとともに、グローバルニッチトップのメーカーを目指していきます。さまざまな機器がスマート化され、遠隔地医療、自動運転が浸透し、超高速通信・高速伝送化が進むことで、さまざまなアプリケーションにあわせた接続が必要になります。さらに信号の種類、小型化、軽量化など、ニーズの多様化・ボリュームの増加が見込まれています。例えば、自動運転関連では、本多通信工業がもともと得意としていた車載カメラに、防水技術を持つミネベアコネクトの中継コネクタを搭載するとともに、

次の10年を見据えた基本戦略

事業の絶対的な永続性の観点から、8本槍製品を構成する5分野を将来のコア事業として力強く成長させることが、SEとして最も重要な課題であると認識しています。そのために、サブコアビジネスが生み出すキャッシュを成長原資として8本槍製品を強化することが基本戦略となります。その執行は、①自律的な成長、②これらの事業を包含する新製品の開発、③これらの事業を有効に活用できると思われる会社のM&Aをおこなうことで達成されます。

ECUにはミネベアミツミの汎用品を統合することで、カメラからECU、コネクタ・ケーブル・ハーネスまでを、トータルソリューションとして提供できるようになります。また、カメラの見る「ビューイング」・測る「センシング」から、解析ECUまで、遅延・劣化せず高速動作対応が可能になります。3社の統合により、このような高付加価値製品を生み出し、収益性の向上に努めていきます。



社会的課題解決製品の開発と部品供給

当社の大きな成長ドライバーであるアナログ半導体において、ミツミとエイブリックの「相合」製品だけでなく、それぞれの担当・棲み分けを明確化しました。ミツミは、大量生産型のビジネスおよびパワー系の半導体（IGBT、SiCなど）を強化してまいります。エイブリックは、高集積AFE（アナログフロントエンド）などの多品種少量生産製品を成長ドライバーとしていきます。さらに、2023年に経営統合したSSCにより、半導体設計を強化してまいります。

これらの製品は、当社の収益を押し上げるだけではなく、社会課題解決にも直結しています。

ミネベアミツミ At a Glance P.18

パワー半導体の一つであるIGBTは、EVや産業機械を主な用途としています。当社は、EV時代を見据えたシリコンの性能限界に迫る高性能IGBTの開発を目指し、滋賀工場の活用、チップ売りに特化したビジネス展開により、低損失・高速・高破壊耐量を極め、パワー機器の省エネに貢献していきます。さらに、IGBTを上回る高耐圧の特徴を持つSiCもラインナップに加わることで、省エネルギー化・カーボンニュートラルにより一層貢献してまいります。

